

# 株式会社バイ・テクノロジー

2024年3月期(第27期) 第3四半期

## 決算補足説明資料

2024年2月9日

# 2024年3月期 第3四半期決算の要旨

## ▶ Q3(9カ月)は概ね計画通りに進捗

- ▶ 売上高:191億円(前年比▲36.1%)、営業損失20億円(前年営業利益1.2億円)
- ▶ FPD装置の売上減少や、半導体関連の新製品の立上げ・のれん償却等の費用増により損失が拡大

## ▶ 半導体・フォトリソ装置事業は新製品投入効果等で売上は急増

- ▶ Q3(9か月)売上高:73億円(Q2比116%増)、営業損失:▲10億円(Q2損失:▲2億円)
- ▶ 新製品の投入効果もあり売上は急拡大
- ▶ 損失の主な要因は、売上増に伴う固定費負担率の変化(VT単体)、新製品関連費用、のれん償却等

## ▶ 受注についてはQ3は減速、Q4の回復を見込む

- ▶ FPD関連の商談に加え、半導体関連製品の引合い増から受注回復を期待
- ▶ 2024年1月～6月(6カ月)の累計受注高については、220億円超を目指す状況

## ▶ 通期業績予想の変更なし

# 全社連結業績サマリー

▶ 概ね計画通りの進捗、主にFPD装置の売上減少や、半導体関連での費用増から減収減益

(百万円)	2023年3月期Q3累計		2024年3月期Q3累計		
	金額	構成比	金額	構成比	前年同期比
売上高	29,892	100.0%	19,103	100.0%	▲36.1%
売上総利益	7,204	24.1%	5,001	26.2%	▲30.6%
営業利益(損失▲)	119	0.4%	▲2,077	—	—
経常利益(損失▲)	743	2.5%	▲1,900	—	—
親会社株主に帰属する四半期純利益(損失▲)	646	2.2%	▲1,387	—	—

# 各セグメントの連結売上高・営業利益の状況

## ▶ 半導体：新製品投入の効果等から増収

- ・ 開発費/売上増に伴う固定費負担比率の変化(VT単体\*)/のれん償却/新会社関連等から費用が増加し損失拡大
- ・ \*VT単体でセグメント毎に売上比率に応じ販管費を按分(会計ルール)

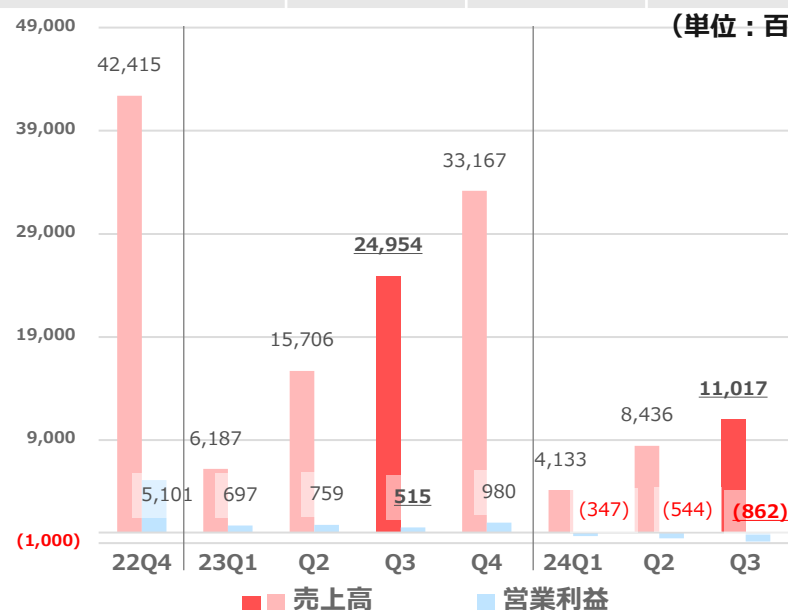
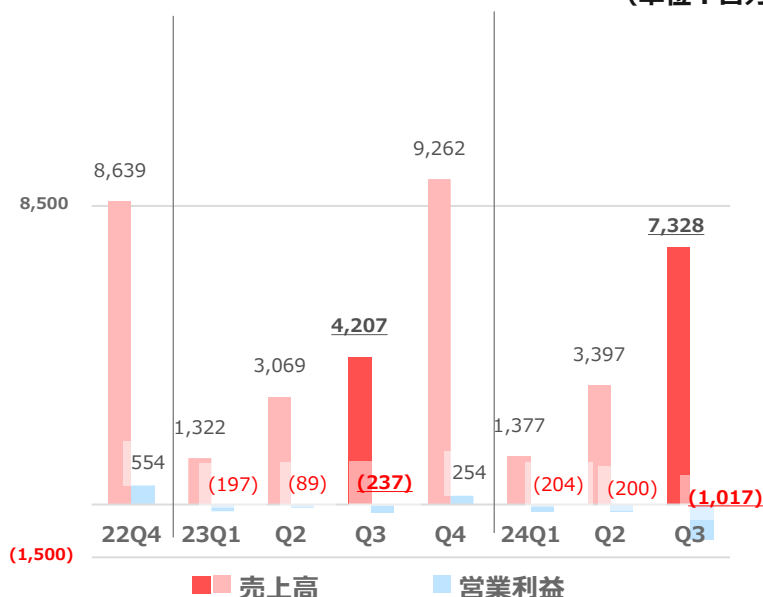
## ▶ FPD：売上減とプロダクトミックス変化で減収減益

半導体・ フォトマスク*1	23年3月Q3 (9カ月)	24年3月Q3 (9カ月)	前年比
売上高	4,207	7,328	+74.2%
営業損失 (セグメント利益率)	▲237 (-%)	▲1,017 (-%)	(-%)

(単位：百万円)

FPD*2	23年3月Q3 (9カ月)	24年3月Q3 (9カ月)	前年比
売上高	24,954	11,017	▲55.9%
営業利益(損失▲) (セグメント利益率)	515 (2.1%)	▲862 (-%)	(-%)

(単位：百万円)

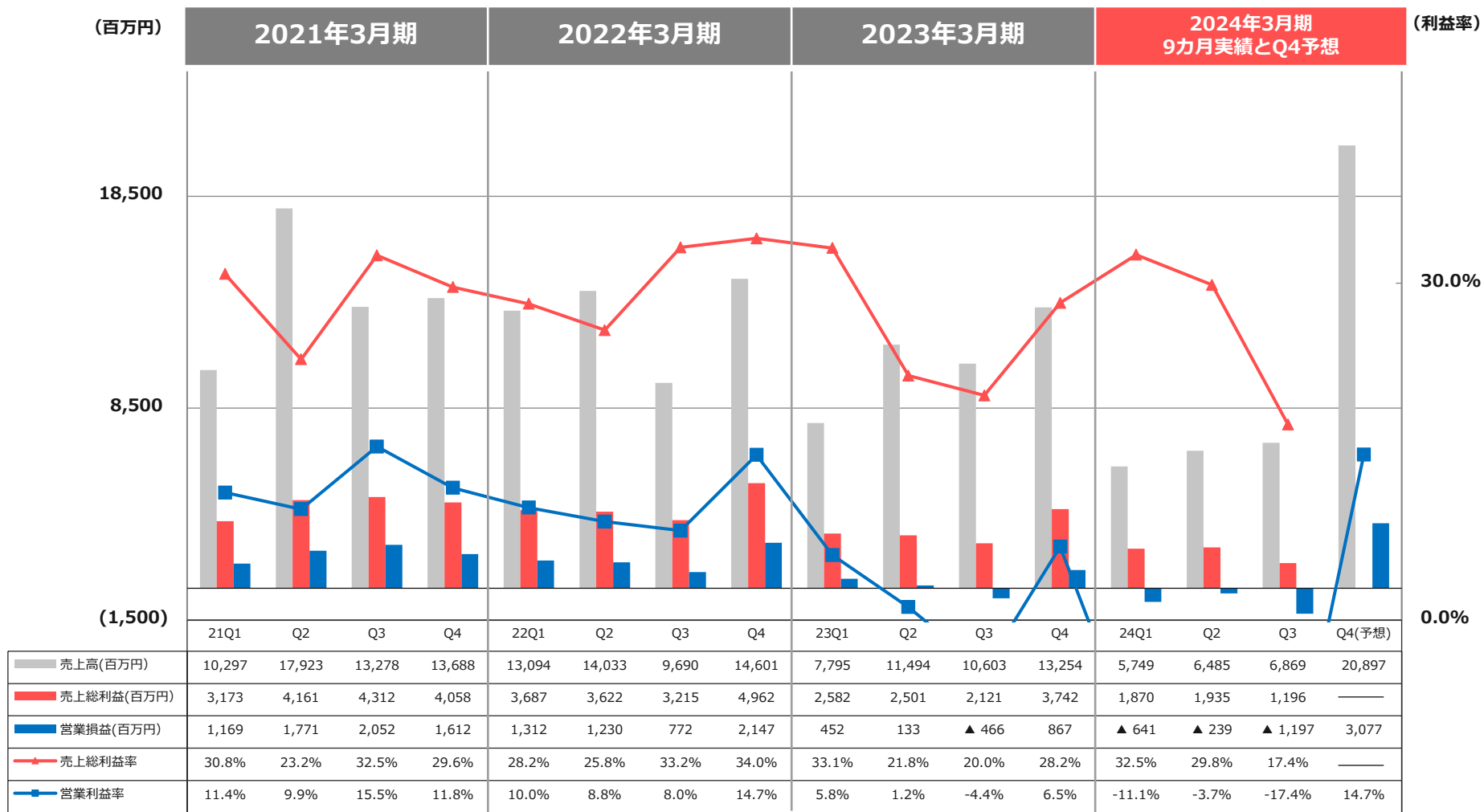


\*1 半導体・フォトマスク装置事業：半導体製造工程における製造装置、検査装置及びフォトマスク用装置等の開発・設計・製造・販売・関連サービス、及びPCB用装置で構成

\*2 FPD装置事業：FPD製造工程における製造装置、検査装置等の開発、設計、製造、販売、関連サービス及びOLED用蒸着マスクをはじめとする部材等で構成

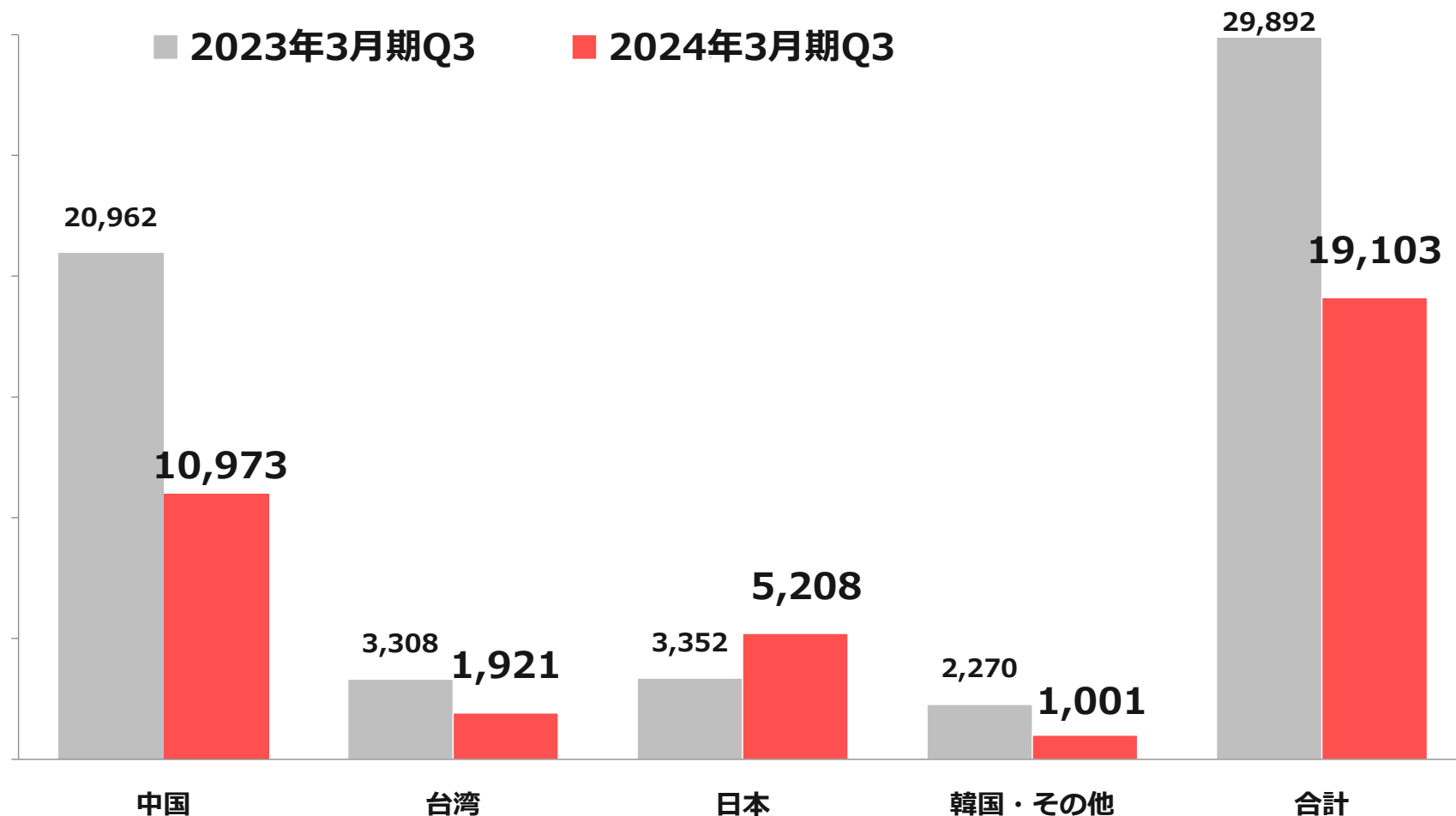
# 四半期の売上・利益の推移実績とQ4の見通し

▶ Q4および通期予想の変更無し



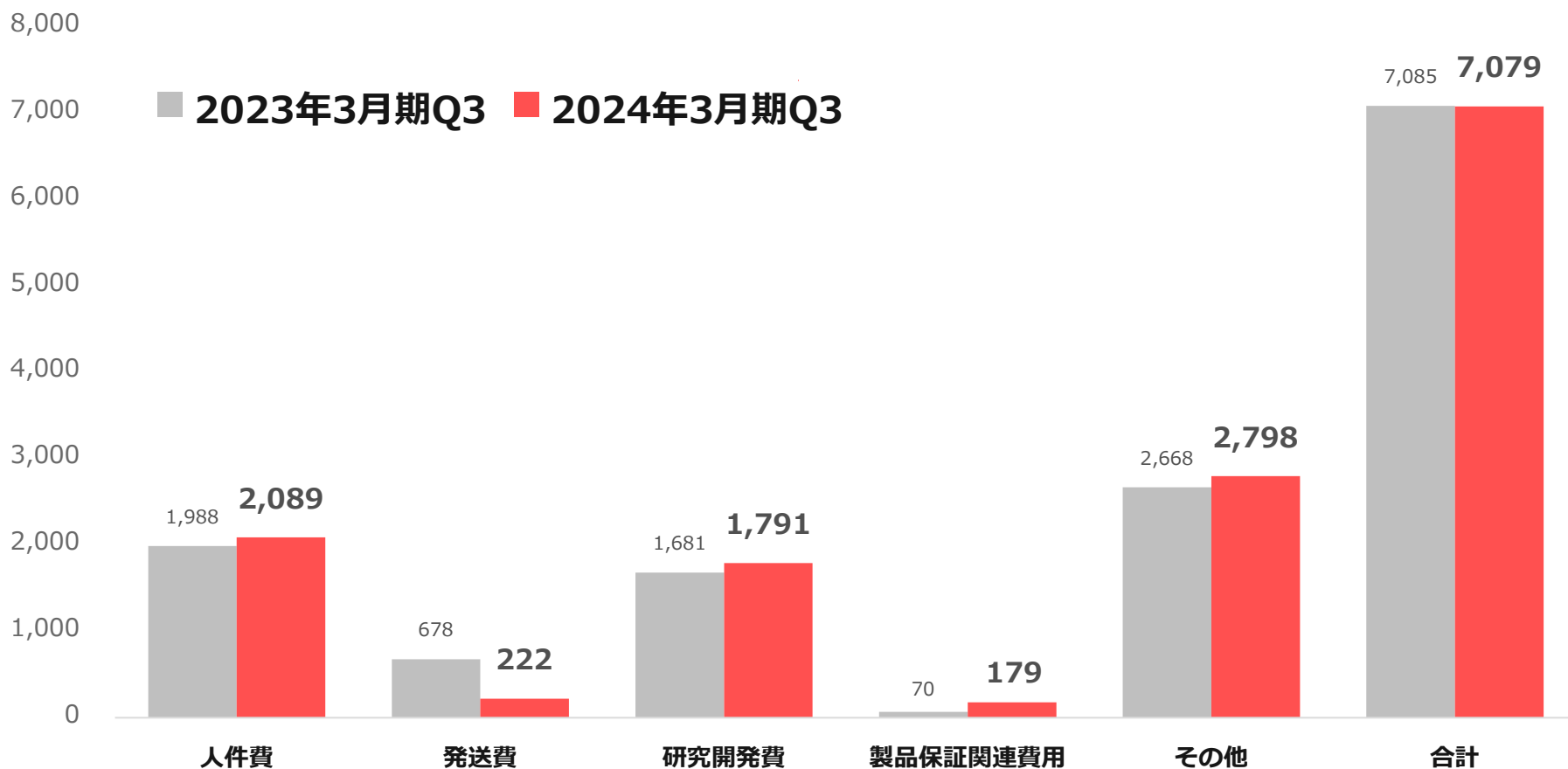
# (参考) 地域別連結売上高 (単位：百万円)

- ▶ 半導体へのシフト進行：中国内のFPD投資が減少、国内で半導体関連の売上が増加
- ・ 中国比率：57.4%(前年同期比：12.7%減少)



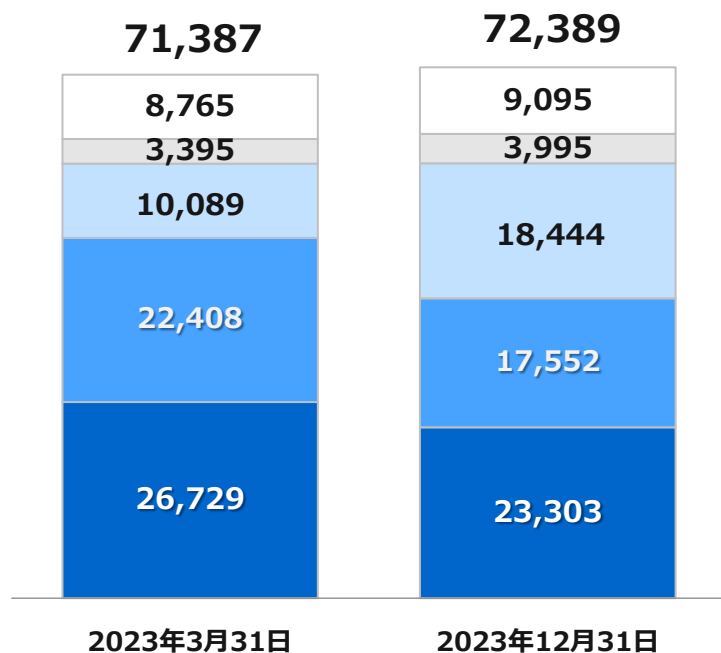
# 販売費及び一般管理費 (単位：百万円)

▶ FPD装置の売上減、半導体製品開発強化、コロナ後の対面での販促活動増



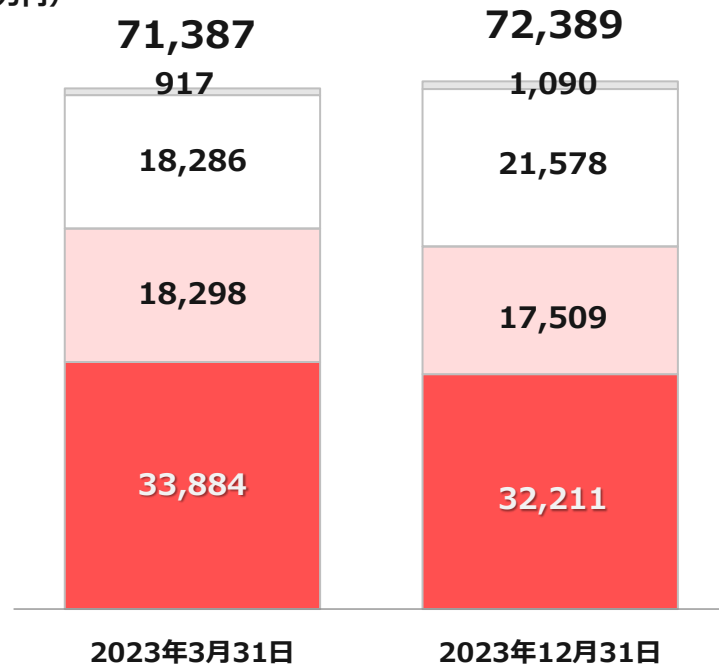
# 連結貸借対照表

総資産  
(単位：百万円)



■ 現金及び預金 ■ 受取手形及び売掛金 ■ 棚卸資産  
■ 其他流動資産 ■ 固定資産

負債・純資産  
(単位：百万円)



■ 純資産 ■ 其他流動負債  
■ 借入金（短期・長期） ■ 其他固定負債



# 受注・受注残の状況：Q3は想定よりやや弱いがQ4の回復を予想

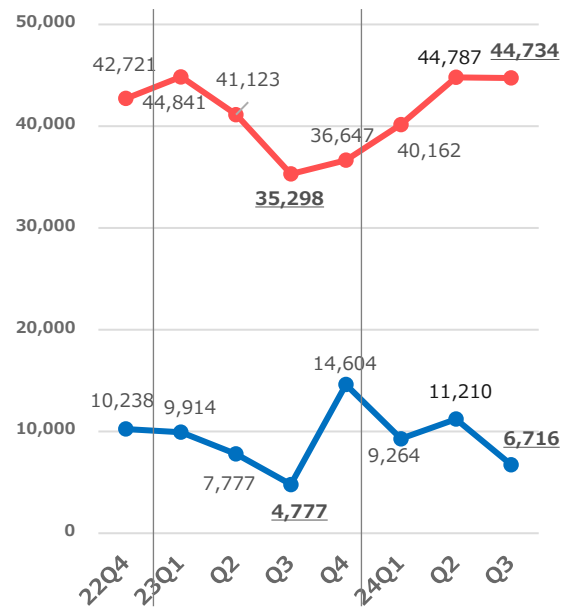
## ▶ 半導体・フォトマスク装置事業：評価・デモリソースの逼迫等から、受注は一時停滞

- ▶ フォトマスク関連の具体的な商談は高水準を維持、Q4回復を予想
- ▶ シリコンウェハやラボ関係の受注や引合の状況は、Q2と同じ水準

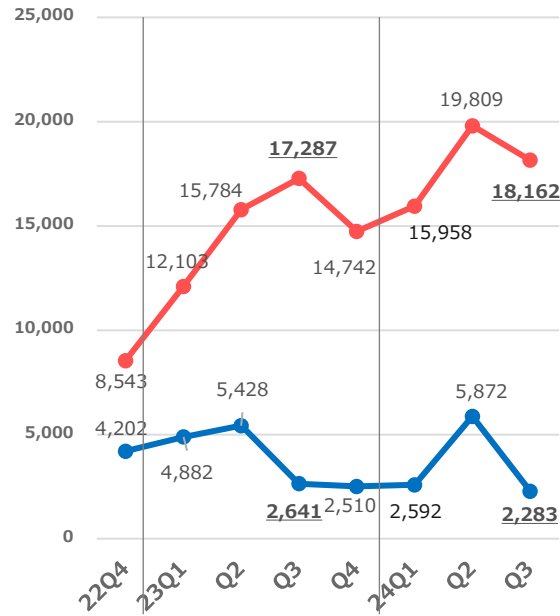
## ▶ 商談・引合いの状況：総額300億円以上(FPD160億以上/半導体140億以上)

- ▶ 成約・受注を目指し、受注活動、製品開発を強化

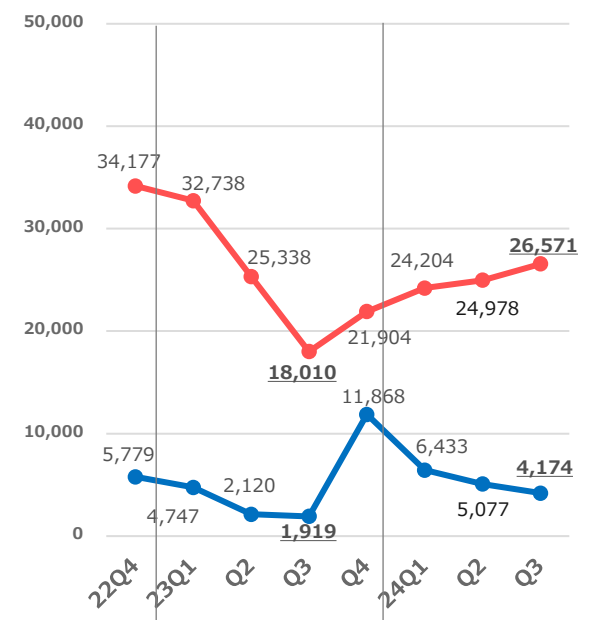
全社	23年Q3	24年Q3	YoY
受注(3カ月)	4,777	6,716	+40.6%
受注残	35,298	44,734	+26.7%



半導体・ フォトマスク	23年Q3	24年Q3	YoY
受注(3カ月)	2,641	2,283	▲13.6%
受注残	17,287	18,162	+5.1%



FPD	23年Q3	24年Q3	YoY
受注(3カ月)	1,919	4,174	+117.5%
受注残	18,010	26,571	+47.5%



(単位：百万円)

# 通期業績及び配当予想

▶ 2023年5月12日公表の内容から変更無

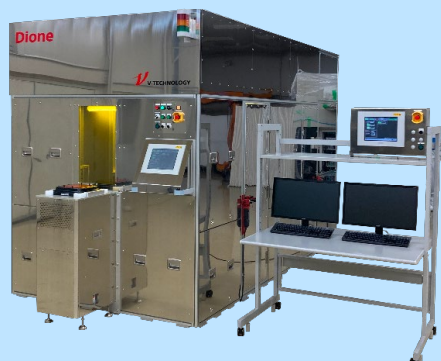
(百万円)	2023年3月期実績		2024年3月期 業績および配当の予想 (2024年2月9日現在)		
	金額	構成比	金額	構成比	前期比
売上高	43,146	100.0%	40,000	100.0%	▲7.3%
営業利益	986	2.3%	1,000	2.5%	+1.4%
経常利益	1,700	3.9%	850	2.1%	▲50.0%
親会社株主に 帰属する当期純利益	260	0.6%	550	1.4%	+111.3%
EPS(円)		26.92		56.88	—
配当(円)	中間	60円	30円(実績)		▲30円
	期末	30円	30円(予想)		—

# | トピックス

# 半導体・フォトマスク装置事

## ▶ 4つの新製品を納品開始

### フォトマスク用装置



検査時間を最大50%短縮  
省スペース設計

欠陥検査装置「Dione」



測定再現性：3nm  
(10億分の1メートル)

レジストレーション装置「PMARS」



初号機出荷

### シリコンウェハ用装置



業界最高速：毎時133枚  
(12インチウェハ換算)

結晶欠陥検査装置

### PCB/インターポージャー基板用装置



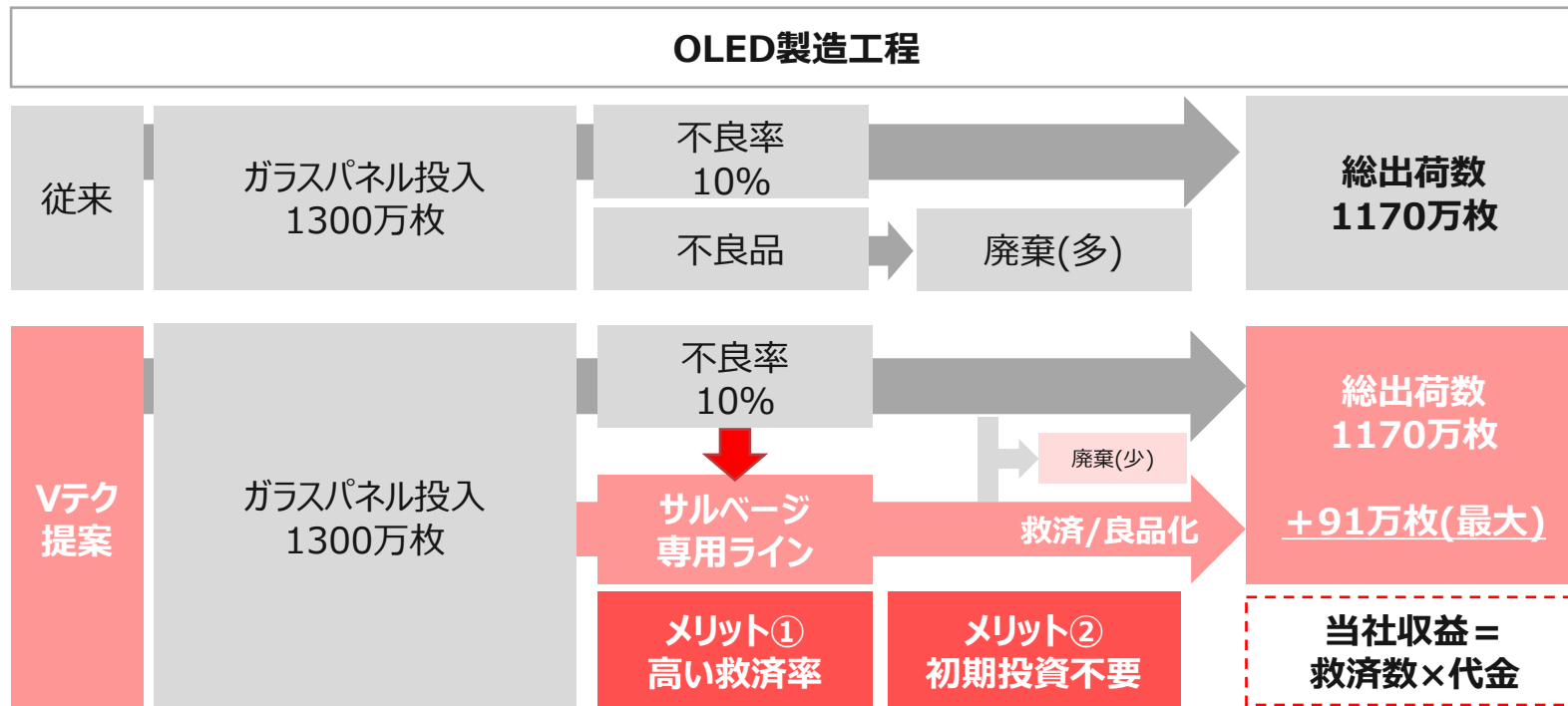
量産用として  
業界最高速・最高精細

DI露光装置「IMAGINA01P」

# F P D装置事業…サルベージサービスが4月より本格的にスタート

## ▶ 装置ビジネスに続く新しいビジネス

- ▶ サルベージ工程を当社が客先に設置、従量制サービスを提供(下図)
- ▶ メリット：①高い救済率、②お客様による初期投資の負担が小さい



(図) サルベージ工程と収益モデルについて(数値は仮)

# 注記事項

## ▶ 将来見通し

本資料に記載されている当社の計画、戦略、見通し及びその他の歴史的事実でないものは、将来に関する見通しであり、これらは現在入手可能な期待、見積、予想に基づいています。これらの期待、見積、予想は、経済情勢・市況の変化、競争環境の変化、顧客のある国の政策変化、係争中及び将来の訴訟の結果など多くの潜在的リスク、不確実な要素、過程の影響を受けますので、実際の業績は見通しから大きく異なる結果となる可能性があります。従って、これら将来予想に関する記述に全面的に依拠することは差し控えて頂きますようお願いいたします。また、当社は新しい情報、将来の出来事などに基づきこれらの将来予測を更新する義務を負うものではありません。

## ▶ 数字の処理

記載された金額は、単位未満を切り捨て処理、比率は単位金額で処理した結果を四捨五入している為、内訳と一致しない場合があります。

## お問合せ先

社長室 IRグループ  
[vtj-mng-pre@vtec.co.jp](mailto:vtj-mng-pre@vtec.co.jp)

